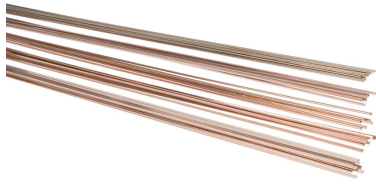


HARRIS 15 (L-Ag15P) blank

398-003114-15500



- Kupfer-Phosphor-Silber-Legierung mit sehr guten Kapillareigenschaften
- Durch die Düninflüssigkeit werden hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erreicht
- Verfügt über eine gute Benetzung, die für dichte und porenfreie Verbindungen sorgt
- Hohe Duktilität (plastische Verformbarkeit) auch bei tieferen Temperaturen
- **Anwendungen**
- Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen von -70 °C bis 150 °C
- Für Verbindungen von Kupfer mit Kupfer oder von Kupferlegierungen (Messing, Bronze, Rotguss) geeignet
- Auf Flussmittel kann wegen des Phosphor-Gehaltes verzichtet werden
- Für den Einsatz bei schwefelhaltigen Medien sowie für Verbindungen von Stählen (Fe) und Nickellegierungen ist dieses Lot nicht geeignet
- Kupferinstallationen: Elektroindustrie, Klimaanlagebau, Kühlanlagen, Wärmetauscher usw.

Normen	ISO 17672 , CuP 284		
	DIN EN 1044 , CP 102		
	DIN 8513 , L-Ag15P		
Ø	1.5 mm		
Chemische Analyse	Cu	P	
	Rest	4.7%	14.5%
Zugfestigkeit, Rm	250 N/mm ²		
Länge	500 mm		
Schmelzbereich	645 °C - 800 °C		
Arbeitst.	700 °C		
Dichte	8.4 g/cm ³		
Ausführung	vierkant, blank		